



2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年2月8日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社

上場取引所 東

コード番号 6590 URL <https://www.shibaura.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 今村 圭吾

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 専務執行役員経営管理本部長 (氏名) 池田 賢一 TEL 045-897-2425

四半期報告書提出予定日 2024年2月13日 配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無：有（当社ウェブサイトには決算説明資料を掲載予定です。）

四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第3四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第3四半期	47,899	5.4	8,104	△2.5	7,999	2.8	6,050	△1.4
2023年3月期第3四半期	45,457	35.0	8,316	179.7	7,782	175.0	6,139	303.1

(注) 包括利益 2024年3月期第3四半期 6,367百万円 (△0.1%) 2023年3月期第3四半期 6,371百万円 (274.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第3四半期	457.79	-
2023年3月期第3四半期	463.08	-

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第3四半期	87,680	36,048	41.1	2,741.91
2023年3月期	81,887	33,007	40.3	2,488.89

(参考) 自己資本 2024年3月期第3四半期 36,048百万円 2023年3月期 33,007百万円

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産を算定しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	-	0.00	-	560.00	560.00
2024年3月期	-	0.00	-	-	-
2024年3月期（予想）	-	-	-	170.00	-

(注) 1. 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：有

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期（予想）の1株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「-」と記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の2024年3月期（予想）の期末配当金は510円00銭、年間配当金合計は510円00銭となります。

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	66,000	8.2	10,500	△3.7	10,000	△4.9	7,450	△19.0	563.65

(注) 1. 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：有

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期（予想）における通期の1株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮した金額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は1,690.95円となります。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期3Q	13,971,900株	2023年3月期	15,577,857株
② 期末自己株式数	2024年3月期3Q	824,667株	2023年3月期	2,316,042株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期3Q	13,217,417株	2023年3月期3Q	13,258,008株

（注）当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する主旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

①業績全般について

当第3四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、スマートフォン、パソコンの需要低下などを受け、半導体業界においてはメモリ向け、ウェーハ向けを中心に設備投資の減速が見られ、FPD (Flat Panel Display) 業界においては全般的に設備投資が低調な状況が継続しました。その一方で、半導体業界においてIoT、5G、AIなどの需要は引き続き底堅く、ロジック/ファウンドリ向け、パワーデバイス向けなどの設備投資がいずれも堅調に推移しました。また、いずれの業界においても部品や部材の供給が不安定な状況が続きました。

このような環境の中、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高は、前年同期に比べ半導体分野では増加、FPD分野では減少し、全体では47,899百万円（前年同期比5.4%増）となりました。利益面では、半導体分野の売上増加が寄与したものの、研究開発の強化などによる販売費及び一般管理費の増加などにより営業利益は8,104百万円（前年同期比2.5%減）、為替の影響から経常利益は7,999百万円（前年同期比2.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は6,050百万円（前年同期比1.4%減）となりました。

なお、受注高は、半導体分野の後工程では先端パッケージ向け装置が堅調に推移しましたが、前工程ではウェーハ向け装置を中心に一部顧客の設備投資計画の見直しがあり、高水準であった前年同期に比べ減少しました。一方FPD分野は低調に推移しました。この結果、当第3四半期連結累計期間における受注高は46,586百万円（前年同期比20.9%減）となりました。

②セグメントの業績について

主な事業セグメントの業績は次のとおりです。

(ファインメカトロニクス部門)

売上高は、半導体前工程ではロジック/ファウンドリ向け装置及びウェーハ向け装置がいずれも順調に推移し、前年同期に比べ増加しました。一方FPD前工程は低調で、前年同期に比べ減少しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ増収となり、35,551百万円（前年同期比13.9%増）となりました。

セグメント利益は、半導体前工程での売上増加により、7,287百万円（前年同期比5.3%増）となりました。

なお、受注高は、半導体前工程ではロジック/ファウンドリ向け装置及びマスク向け装置を中心に堅調に推移したものの、ウェーハ向け装置を中心に一部顧客の設備投資計画の見直しなどもあり、特に好調であった前年同期に比べ減少しました。FPD前工程では市況の影響を受け低調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が減少し、28,769百万円（前年同期比35.8%減）となりました。

(メカトロニクスシステム部門)

売上高は、半導体後工程では先端パッケージ向け装置が堅調に推移し、前年同期に比べ増加しました。FPD後工程では、前年度、特に後半の受注が低調だったことを受け前年同期に比べ大幅に減少しました。真空応用装置は、半導体分野向けが堅調に推移し前年同期に比べ増加しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ減収となり、8,849百万円（前年同期比20.9%減）となりました。

セグメント利益は、FPD後工程の売上減少の影響により、1,022百万円（前年同期比35.6%減）となりました。

なお、受注高は、半導体後工程では先端パッケージ向け装置が前年同期に比べ大幅に増加しました。FPD後工程では市況の影響を受け、前年同期に比べ大幅に減少しました。真空応用装置では、半導体分野向けを中心に順調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が増加し、13,113百万円（前年同期比19.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,792百万円増加し87,680百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が2,765百万円、商品及び製品が925百万円、仕掛品が1,519百万円増加したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ2,751百万円増加し51,632百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3,293百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ3,041百万円増加し36,048百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により6,050百万円増加した一方で、配当金の支払いにより2,477百万円減少したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間の業績進捗等を踏まえ、2023年11月9日に公表の予想から、売上高は65,000百万円から66,000百万円へ、営業利益は10,000百万円から10,500百万円へ、経常利益は9,700百万円から10,000百万円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は7,200百万円から7,450百万円へ、それぞれ上方修正いたします。

また、通期業績予想の修正を踏まえ、配当予想につきましても併せて修正しております。本日(2024年2月8日)公表の「2024年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,175	25,260
受取手形、売掛金及び契約資産	31,844	34,609
電子記録債権	799	996
商品及び製品	1,376	2,301
仕掛品	4,935	6,455
原材料及び貯蔵品	200	383
未収入金	2,203	2,339
その他	315	771
貸倒引当金	△1,440	△1,235
流動資産合計	67,409	71,882
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	28,572	30,066
減価償却累計額	△20,489	△20,821
建物及び構築物（純額）	8,082	9,245
機械装置及び運搬具	7,401	9,079
減価償却累計額	△5,308	△6,100
機械装置及び運搬具（純額）	2,092	2,978
工具、器具及び備品	1,366	1,585
減価償却累計額	△1,117	△1,215
工具、器具及び備品（純額）	248	369
土地	119	119
リース資産	96	150
減価償却累計額	△63	△79
リース資産（純額）	33	70
建設仮勘定	1,086	825
有形固定資産合計	11,663	13,610
無形固定資産		
特許権	388	410
その他	216	173
無形固定資産合計	604	584
投資その他の資産		
投資有価証券	0	0
長期前払費用	12	24
繰延税金資産	1,984	1,353
その他	214	225
貸倒引当金	△1	△1
投資その他の資産合計	2,211	1,603
固定資産合計	14,478	15,798
資産合計	81,887	87,680

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,518	14,811
電子記録債務	3,897	4,755
短期借入金	3,750	3,750
1年内返済予定の長期借入金	—	2,700
リース債務	16	22
未払法人税等	1,684	473
未払費用	3,926	3,307
前受金	8,099	8,513
役員賞与引当金	146	108
製品保証引当金	108	131
その他	846	1,088
流動負債合計	33,995	39,662
固定負債		
長期借入金	5,000	2,300
リース債務	20	51
退職給付に係る負債	6,380	6,107
役員退職慰労引当金	28	39
修繕引当金	310	325
資産除去債務	67	67
長期預り保証金	3,078	3,078
固定負債合計	14,885	11,969
負債合計	48,880	51,632
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,761	6,761
資本剰余金	9,037	6,939
利益剰余金	20,944	23,843
自己株式	△3,998	△2,074
株主資本合計	32,745	35,470
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	535	734
退職給付に係る調整累計額	△274	△156
その他の包括利益累計額合計	261	578
純資産合計	33,007	36,048
負債純資産合計	81,887	87,680

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
売上高	45,457	47,899
売上原価	27,804	28,752
売上総利益	17,652	19,146
販売費及び一般管理費	9,336	11,042
営業利益	8,316	8,104
営業外収益		
受取利息	3	11
受取配当金	0	0
為替差益	95	419
その他	45	119
営業外収益合計	144	550
営業外費用		
支払利息	59	53
固定資産廃棄損	47	156
デリバティブ評価損	500	303
その他	70	141
営業外費用合計	678	655
経常利益	7,782	7,999
税金等調整前四半期純利益	7,782	7,999
法人税、住民税及び事業税	1,482	1,321
法人税等調整額	160	627
法人税等合計	1,643	1,948
四半期純利益	6,139	6,050
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,139	6,050

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	6,139	6,050
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	146	198
退職給付に係る調整額	84	118
その他の包括利益合計	231	316
四半期包括利益	6,371	6,367
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,371	6,367

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(1) 自己株式の消却

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月31日付で自己株式535,319株の消却を実施いたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が2,098百万円、利益剰余金が674百万円、自己株式が2,772百万円減少しております。

(2) 自己株式の取得

当社は、2023年8月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月22日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) により、自己株式41,600株の取得を行いました。この結果、当第3四半期連結累計期間において自己株式が859百万円増加しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカトロニクス	メカトロニクスシステム	流通機器システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	31,210	11,185	1,663	1,397	45,457
セグメント間の内部売上高又は振替高	35	166	0	68	271
計	31,245	11,352	1,663	1,466	45,728
セグメント利益	6,920	1,588	45	373	8,928

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 (差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	8,928
全社費用 (注)	△622
その他	△523
四半期連結損益計算書の経常利益	7,782

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク システム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	35,551	8,849	2,159	1,338	47,899
セグメント間の内部売上高又は振替高	40	200	—	70	310
計	35,591	9,049	2,159	1,408	48,210
セグメント利益	7,287	1,022	236	288	8,834

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	8,834
全社費用(注)	△771
その他	△63
四半期連結損益計算書の経常利益	7,999

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。